

**AT&S**Austria Technologie & Systemtechnik  
Aktiengesellschaft

# Pressemitteilung

## 06/05/2010

### IPC prämiert Forschungsarbeit des von AT&S geleiteten EU-Projekts HERMES

Im Rahmen der IPC APEX EXPO™ in Las Vegas wurde der Technologiebeitrag von HERMES zum Thema Chipembedding als „Best International Conference Paper“ ausgezeichnet. Die Forschungsarbeit „Industrial PCB Development Using Embedded Passive & Active Discrete Chips Focused on Process and DfR“ ist das Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit von Thales Corporate Services und AT&S innerhalb des EU-geförderten HERMES-Projekts.

Im Mittelpunkt des ausgezeichneten Papers stehen die technischen Möglichkeiten des Chipembedding sowie Zuverlässigkeitsaspekte, die innerhalb des HERMES-Projekts untersucht werden. AT&S hat sich in den vergangenen 15 Jahren weltweit als Technologietreiber im Bereich der Miniaturisierung etabliert. Im Rahmen des internationalen und von der EU geförderten HERMES-Projekts arbeitet AT&S mit namhaften internationalen Partnern u. a. aus der Industrie, der Automobilbranche und dem Bereich Luftfahrt zusammen. Vorrangiges Ziel der neuen Technologie ist die Steigerung der Performance von Leiterplatten durch Chipintegration und die Integration neuer Funktionen. Ein weiterer Schwerpunkt der Projektarbeit ist die Konzeption und der Aufbau der Wertschöpfungskette, um neben technischen Aspekten auch die organisatorischen Rahmenbedingungen für die Zukunft festzulegen.

Die IPC prämiert jährlich im Rahmen der APEX EXPO™ die besten Papers der technischen Konferenz; ausgezeichnet wurden heuer jeweils die zwei besten US-amerikanischen und die zwei besten internationalen Arbeiten. Der Anfang April 2010 prämierte Forschungsbeitrag sowie Bildmaterial stehen auf der HERMES Website unter [www.hermes-ect.net](http://www.hermes-ect.net) zum Download zur Verfügung (*Bericht in englischer Sprache*).

#### Über HERMES

Das von AT&S initiierte und von der EU geförderte HERMES-Projekt (**H**igh density integration by **E**MBEDDED chips for **R**educed sized **M**odules and **E**lectronic **S**ystems) forscht an der nächsten technischen Innovation bei Leiterplatten – einer neuen Packaginglösung für Halbleiter, die weit über die heutigen Verbindungsmöglichkeiten hinausgeht. Mit der Industrialisierung dieser Technologie öffnet sich eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Medizinbereich (z. B. neue Generationen von Hörgeräten) und in funktionellen Modulen wie z.B. GPS. Die Zukunft der Mobile Device Produkte liegt in der Steigerung der Performance und der Integration neuer Funktionen; gerade diese Performancesteigerung wird HERMES ermöglichen. Weitere Infos auch unter [www.hermes-ect.net](http://www.hermes-ect.net)

#### Über AT&S

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der leistungsstärksten Leiterplattenproduzenten. Insbesondere im höchsten Technologiesegment, den HDI-Microvia-Leiterplatten, welche vor allem in Mobile Devices zum Einsatz kommen, ist AT&S weltweit bestens positioniert. Erfolgreich ist der Konzern auch im Segment der Automotive-Leiterplatten sowie im Industrie- und Medizintechnikbereich tätig. Als internationales Wachstumsunternehmen verfügt AT&S über eine globale Präsenz mit drei Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring, Klagenfurt) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai) und Korea (Ansan nahe Seoul). Weitere Infos auch unter [www.ats.net](http://www.ats.net)

#### Presserückfragen:

Hans Lang, Leiter IR & Communication  
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG  
+43 (0) 1 68 300-9259, [h.lang@ats.net](mailto:h.lang@ats.net), [www.ats.net](http://www.ats.net)